

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012年3月8日(08.03.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/029762 A1

- (51) 国際特許分類:
C08J 3/20 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
B29B 9/08 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
C08G 59/68 (2006.01) B29K 63/00 (2006.01)
H01L 21/56 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/069568
- (22) 国際出願日: 2011年8月30日(30.08.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-196302 2010年9月2日(02.09.2010) JP
特願 2011-185271 2011年8月26日(26.08.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 高橋 良幸 (TAKAHASHI Yoshiyuki) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークラ

イト株式会社内 Tokyo (JP). 宇津木 洋志(UTSUGI Hiroshi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 朝比 一夫, 外(ASAHI Kazuo et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋1丁目18番9号 西新橋ノアビル4階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

[続葉有]

(54) Title: RESIN MOLDED PRODUCT AND PROCESS FOR PRODUCING SAME, RESIN COMPOSITION AND PROCESS FOR PRODUCING SAME, AND ELECTRONIC COMPONENT DEVICE

(54) 発明の名称: 樹脂成形体及びその製造方法、樹脂組成物及びその製造方法ならびに、電子部品装置

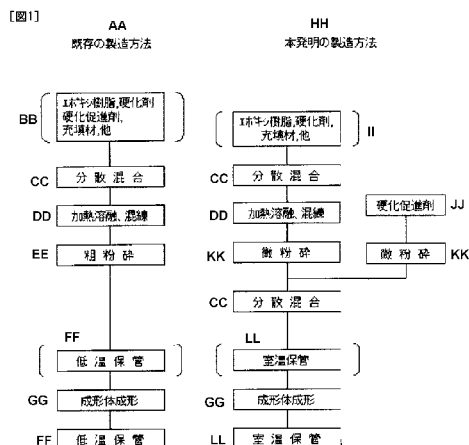


FIG. 1

- AA Existing production processes
BB Epoxy resin, curing agent, curing accelerator, filler, etc.
CC Dispersion and mixing
DD Heating-and-melting, kneading
EE Coarse pulverizing
FF Storage at low temperature
GG Molding of molded product
HH Production process of present invention
II Epoxy resin, curing agent, filler, etc.
JJ Curing accelerator
KK Fine pulverizing
LL Storage at room temperature

(57) Abstract: A process for producing a resin molded product according to the present invention is a process for producing a resin molded product that is made of a resin composition containing an epoxy resin, a curing agent, a curing accelerator, and an inorganic filler, the process involving: a kneading and crushing step of preparing a first powder by mixing, heating and melting, kneading, and crushing a first component that contains an epoxy resin, a curing agent, and an inorganic filler and that does not contain a curing accelerator; a pulverizing step of preparing a second powder by pulverizing a second component containing a curing accelerator; a mixing step of preparing a resin composition by dispersing and mixing the first powder and the second powder; and a molding step of molding a resin molded product by pressurizing the resin composition. Thus, it is possible to produce a resin molded product (particularly, resin tablets for sealing) having excellent long-term storability at room temperature and excellent curability and flowability.

(57) 要約: 本発明の樹脂成形体の製造方法は、エポキシ樹脂、硬化剤、硬化促進剤及び無機質充填材を含む樹脂組成物から構成される樹脂成形体の製造方法であって、エポキシ樹脂、硬化剤及び無機質充填材を含み、かつ前記硬化促進剤を含まない第1組成物を混合、加熱溶融、混練、破碎して第1粉体を得る混練・破碎工程と、硬化促進剤を含む第2組成物を粉砕して第2粉体を得る粉砕工程と、第1粉体と第2粉体とを分散混合して樹脂組成物を得る混合工程と、前記樹脂組成物を加圧して樹脂成形体を成形する成形工程とを有する。これにより、室温での長期保存性に優れ、硬化性や流動性が良好な樹脂成形体(特に封止用樹脂タブレット)が得られる。



GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))